

2013-2017年中国LED封装市场供需预测及发展趋势研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2013-2017年中国LED封装市场供需预测及发展趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/yejing/X05043GR75.html>

报告价格：印刷版：RMB 7000 电子版：RMB 7200 印刷版+电子版：RMB 7500

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

LED封装是指发光芯片的封装，是与市场联系最为紧密的环节。由于封装的技术含量与投资门槛相对较低，因此它是LED产业链中投资规模最大且发展最快的领域。近年来，传统半导体封装企业开始试水LED封装，半导体封装设备厂商逐步加大LED设备的研发和市场推广，封装企业更多向下游应用领域延伸，且不乏有部分实力企业向上游扩张。我国LED封装产品经过十多年的发展，已形成门类齐全的各类封装型号，与国外的封装产品型号基本同步。中国已逐渐成为世界LED封装器件的制造中心，内地LED封装企业的封装产能扩充较快。国内LED封装企业主要分布在珠三角地区，其次是长三角地区。随着更多资本进入大陆封装产业，我国LED封装产能将会进一步扩张。智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国LED封装市场供需预测及发展趋势研究报告》共七章。主要依据国家统计局、国家商务部、国内外相关刊物的基础信息以及LED封装市场研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料。本LED封装行业报告，从行业概况、市场格局、设备及原材料、重点企业等多方面多角度阐述了LED封装市场的总体发展状况，并对未来LED封装市场发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了LED封装市场今后的发展与投资策略。报告对LED封装企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章 LED封装相关概述

第一节 LED封装简介

一、LED封装的概念

二、LED封装的形式

三、LED封装的结构类型

四、LED封装的工艺流程

第二节 LED封装的常见要素

一、LED引脚成形方法

二、LED弯脚及切脚

三、LED清洗

四、LED过流保护

五、LED焊接条件

第二章 LED封装产业总体发展分析

第一节 世界LED封装业的发展

一、发展概况

二、总体特征

三、区域分布

第二节 中国LED封装业的发展

一、发展现状

二、产值增长情况

三、产量增长情况

四、价格分析

五、利好因素

第三节 国内重要LED封装项目的建设进展

一、韩企投资扬州兴建LED封装基地

二、源力光电LED封装线正式投产

三、敬亭园中园LED支架及封装项目开建

四、TCL集团与台企合作建设LED封装厂

五、台企投建南昌高新区大功率LED封装项目

六、台湾连发光电LED封装项目落户铜陵

七、河南LED封装项目试制成功

第四节 SMD LED封装

一、SMD LED封装市场发展简况

二、SMD LED封装技术壁垒较高

三、SMD LED封装产能尚未过剩

四、SMD LED封装受益于芯片价格下降

第五节 LED封装业发展中存在的问题

一、制约我国LED封装业发展的因素

二、国内LED封装企业面临的挑战

三、封装业销售额与海外企业差距明显

四、传统封装工艺成为系统成本瓶颈

第六节 促进中国LED封装业发展的策略

一、做大做强LED封装产业的对策

- 二、发展LED封装行业的措施建议
- 三、LED封装业发展需加大研发投入
- 四、我国LED封装业应向高端转型

第三章 中国LED封装市场格局分析

第一节 LED封装市场发展态势

- 一、中国成中低端LED封装重要基地
- 二、国内LED封装企业发展不平衡
- 三、中国LED封装市场缺乏大型企业
- 四、LED产业上游厂商涉足封装市场
- 五、台湾LED封装产能向大陆转移

第二节 LED封装企业发展格局

- 一、2011年LED封装企业区域分布
- 二、2012年LED封装企业加速上市

第三节 广东省LED封装业

- 一、主要特点
- 二、重点市场
- 三、发展趋势

第四节 LED封装市场竞争格局

- 一、中国采购影响世界封装市场格局
- 二、我国LED封装市场各方力量简述
- 三、国内LED封装市场竞争加剧
- 四、本土LED封装企业整合步伐加速

第五节 LED封装企业竞争力简析

- 一、2011年本土封装企业竞争力排名
- 二、2012年本土LED封装企业竞争力排名

第四章 LED封装行业技术研发进展状况

第一节 中外LED封装技术的差异

- 一、封装生产及测试设备差异
- 二、LED芯片差异
- 三、封装辅助材料差异

四、封装设计差异

五、封装工艺差异

六、LED器件性能差异

第二节 中国LED封装技术发展概况

一、封装技术影响LED产品可靠性

二、中国LED业专利集中在封装领域

三、中国LED封装业的技术特点

四、LED封装技术水平不断提升

五、LED封装业技术研发仍需加强

第三节 LED封装关键技术介绍

一、大功率LED封装的关键技术

二、显示屏用LED封装的技术要求

三、固态照明对LED封装的技术要求

第五章 LED封装设备及封装材料的发展

第一节 LED封装设备市场分析

一、我国LED封装设备市场概况

二、LED封装设备国产化亟需加速

三、发展我国LED封装设备业的思路

第二节 LED封装材料市场分析

一、LED封装主要原材介绍

二、我国LED封装材料市场简析

三、部分关键封装原材料仍依赖进口

四、LED封装用基板材料市场走向分析

第三节 LED封装支架市场

一、国内LED封装支架市场格局分析

二、LED封装支架技术未来发展趋势

三、我国LED封装支架市场前景广阔

第六章 LED封装重点企业介绍

第一节 国外主要LED封装重点企业

一、科锐 (CREE)

二、日亚化学（NICHIA）

三、飞利浦（Philips）

四、三星LED（Samsung LED）

五、首尔半导体（SSC）

第二节 中国台湾主要LED封装重点企业

一、亿光电子

二、光宝集团

三、东贝光电

四、宏齐科技

五、台积电

六、艾笛森

第三节 中国内地主要LED封装重点企业

一、国星光电

二、雷曼光电

三、鸿利光电

四、大族光电

五、瑞丰光电

六、升谱光电

七、木林森

第七章 2013-2017年中国LED封装产业发展趋势及前景

第一节 2013-2017年LED封装产业发展趋势

一、功率型白光LED封装技术发展趋势

二、LED封装技术将向模块化方向发展

三、LED封装产业未来发展走向分析

第二节 2013-2017年中国LED封装市场前景展望

一、我国LED封装市场发展前景乐观

二、LED封装产品应用市场将持续扩张

三、中国LED通用照明封装市场规模预测

图表目录

图表：LED产品封装结构的类型

图表：全球前十大封装厂商营业收入情况

图表：全球前十大封装厂商市场占有情况

图表：全球主要LED封装企业的技术特色

图表：世界LED封装产业的区域分布

图表：第三类企业的发展运作模式

图表：国际大部分著名LED企业遵循的发展模式

图表：我国LED封装产业产值及增长情况

图表：我国LED封装产量及增长情况

图表：国内LED封装价格比较

图表：台湾、大陆主要SMD LED企业产能对比

图表：2011年中国大陆SMD LED主要厂商的扩产情况

图表：2011年在大陆扩产的主要港台企业

图表：国星光电LED芯片单价变动对LED封装产品毛利的影响

图表：2011年国内部分封装项目（台湾企业除外）

图表：2011-2012年台湾前8大LED封装厂SMD产能及大陆业务

图表：2011年台湾在大陆投资的LED封装项目

图表：我国LED企业在各领域的分布情况

图表：我国LED封装企业区域分布情况

图表：广东LED封装产量在全国的比例

图表：广东LED封装产值在产业链中的比例

图表：广东部分LED封装企业的优势与特色

图表：部分广东省企业和研究机构的封装技术发明专利分布

图表：广东LED封装企业区域分布情况

图表：广东LED器件封装应用领域

图表：2011年我国LED封装企业竞争力排行榜

图表：2012年我国LED封装企业竞争力排行榜

图表：影响大功率LED封装技术的因素

图表：大功率LED的封装结构

图表：LED封装技术的发展阶段

图表：2010-2012财年Cree综合损益表

图表：2010-2012财年Cree按产品种类分收入状况表

图表：2011-2012年飞利浦集团综合损益表

图表：2011-2012年飞利浦集团各业务部门经营情况

图表：2011-2012年亿光电子综合损益表

图表：2011-2012年亿光电子不同地区收入情况

图表：2012年1-12月国星光电非经常性损益项目及金额

图表：2010年-2012年国星光电主要会计数据

图表：2010年-2012年国星光电主要财务指标

图表：2012年1-12月国星光电主营业务分行业、产品情况

图表：2012年1-12月国星光电主营业务分地区情况

图表：2012年1-12月雷曼光电非经常性损益项目及金额

图表：2010-2012年雷曼光电主要会计数据

图表：2010-2012年雷曼光电主要财务指标

图表：2012年1-12月雷曼光电主营业务分行业、产品情况

图表：2012年1-12月雷曼光电主营业务分地区情况

图表：2010-2012年鸿利光电营业收入和净利润

图表：2010-2012年鸿利光电不同LED产品收入及比重情况

图表：2010-2012年鸿利光电不同LED产品收入及利润情况

图表：2010-2012年鸿利光电LAMP LED产能、产量及销量

图表：2010-2012年鸿利光电SMD LED产能、产量及销量

图表：2010-2012年鸿利光电通用照明产品产能、产量及销量

图表：2012年1-12月大族激光主要财务数据

图表：2012年1-12月大族激光非经常性损益项目及金额

图表：2010-2012年大族激光主要会计数据

图表：2010-2012年大族激光主要财务指标

图表：2012年1-12月大族激光主营业务分行业、产品情况

图表：2012年1-12月大族激光主营业务分地区情况

图表：2010-2012年瑞丰光电主要财务指标

图表：2010-2012年瑞丰光电不同产品销售收入及比重

图表：2010-2012年瑞丰光电不同地区销售收入及比重

图表：2010-2012年瑞丰光电不同产品产能、产量、销量及销售收入

图表：2012年中国LED各应用领域产值分布情况

图表：中国LED通用照明封装市场规模增长情况预测

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/yejing/X05043GR75.html>